

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 3 区分
【発行日】令和 5 年 6 月 16 日(2023.6.16)

【公開番号】特開 2023-67951(P2023-67951A)
【公開日】令和 5 年 5 月 16 日(2023.5.16)
【年通号数】公開公報(特許)2023-089
【出願番号】特願 2023-32122(P2023-32122)
【国際特許分類】

C 0 8 L 63/00(2006.01)

10

C 0 8 K 3/00(2018.01)

C 0 8 K 3/22(2006.01)

H 0 1 L 23/29(2006.01)

【F I】

C 0 8 L 63/00 C

C 0 8 K 3/00

C 0 8 K 3/22

H 0 1 L 23/30 R

【手続補正書】

20

【提出日】令和 5 年 6 月 8 日(2023.6.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

エポキシ樹脂と、硬化剤と、無機充填材とを含有し、

前記無機充填材の粒度分布が、少なくとも 3 つのピークを有し、

30

前記無機充填材が、粒子径が 1 μm 以下のアルミナを含み、

前記無機充填材の粒度分布が、40 μm ~ 70 μm の範囲にピークを有し、

前記無機充填材に占めるアルミナの割合が、60 質量% ~ 90 質量%である封止組成物。

【請求項 2】

前記無機充填材の粒度分布が、0.3 μm ~ 0.7 μm の範囲、7 μm ~ 20 μm の範囲及び 40 μm ~ 70 μm の範囲にピークを有する請求項 1 に記載の封止組成物。

【請求項 3】

前記無機充填材に含まれる粒子径が 1 μm 以下の無機粒子に占めるアルミナの割合が、1 体積% ~ 40 体積%である請求項 1 又は請求項 2 に記載の封止組成物。

【請求項 4】

40

前記無機充填材の平均円形度が、0.80 以上である請求項 1 ~ 請求項 3 のいずれか 1 項に記載の封止組成物。

【請求項 5】

半導体素子と、前記半導体素子を封止してなる請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれか 1 項に記載の封止組成物の硬化物と、を含む半導体装置。